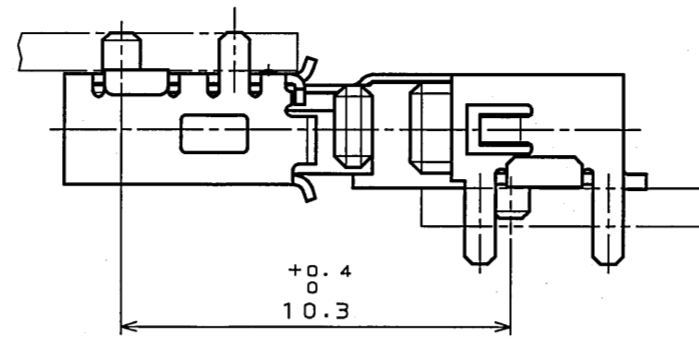
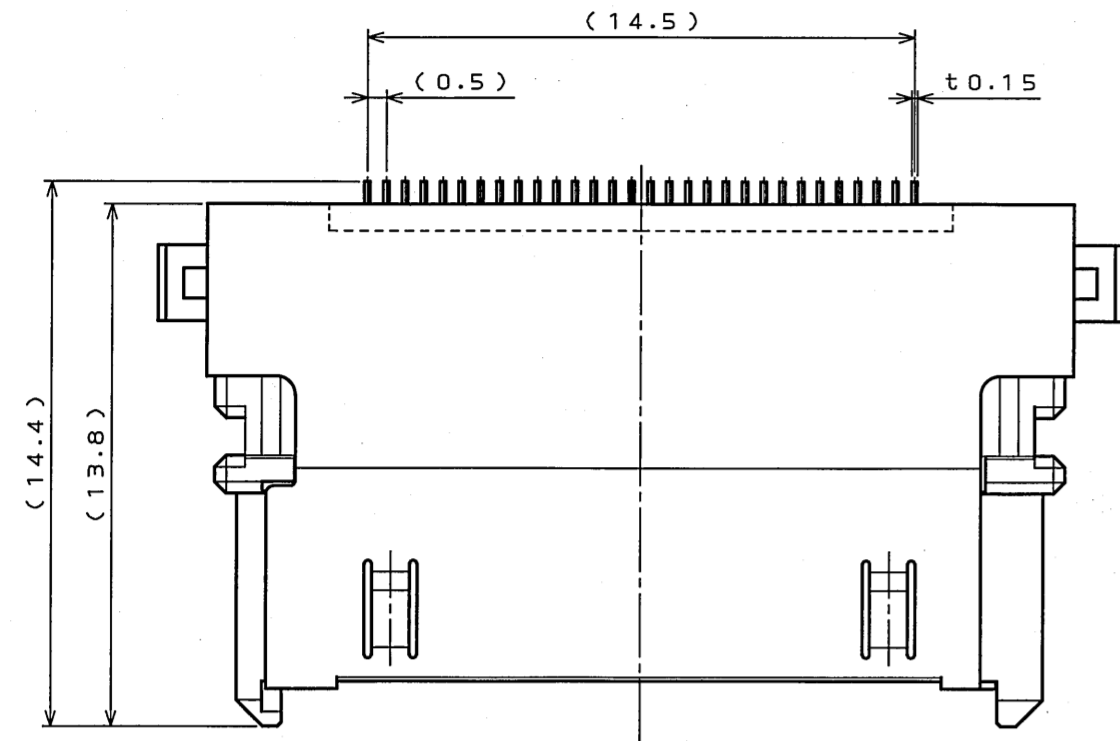
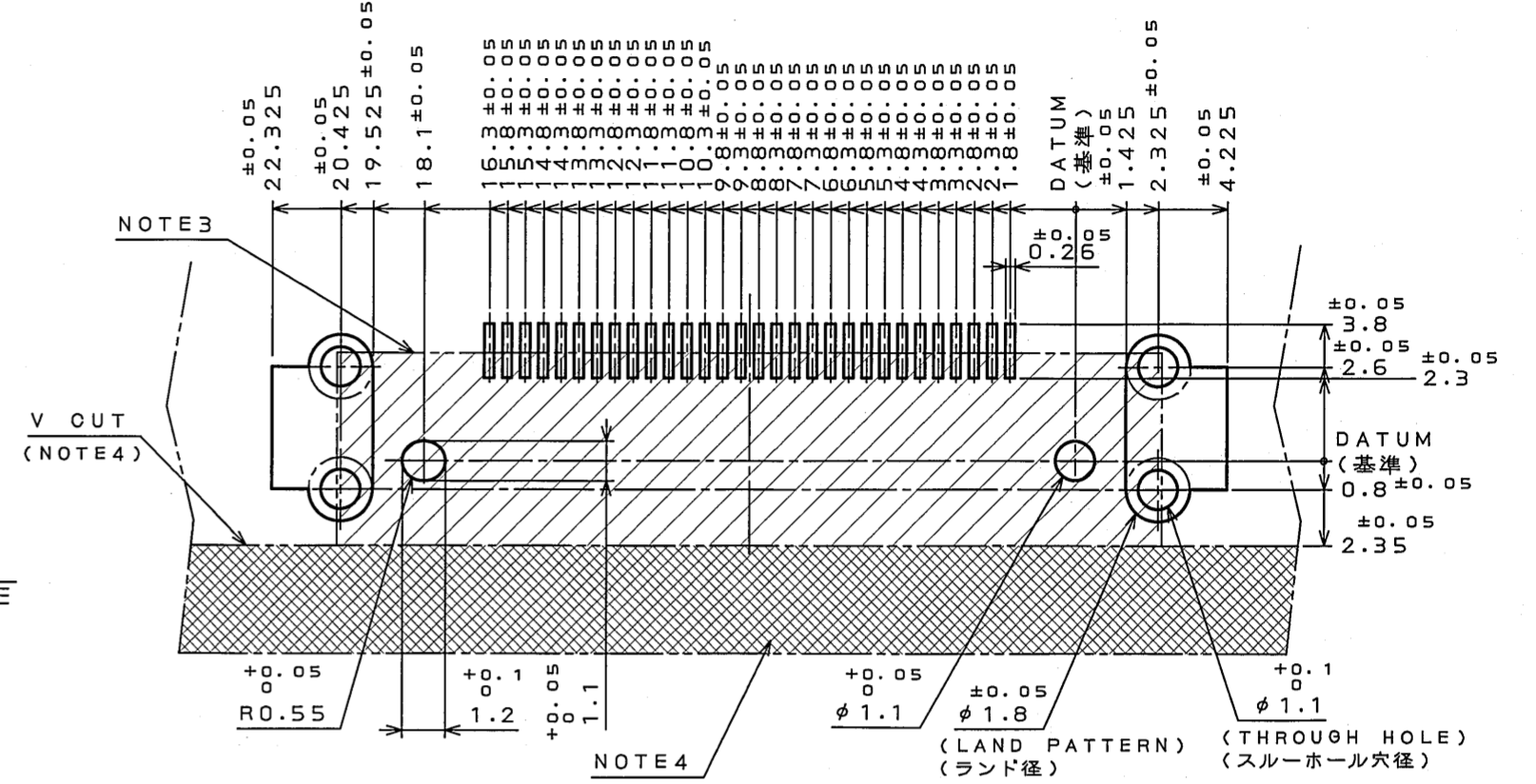
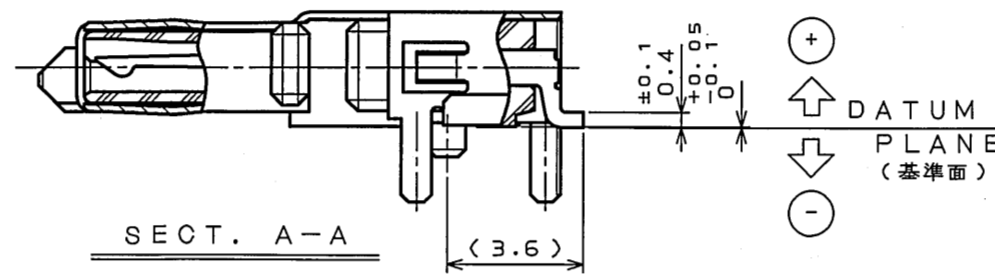


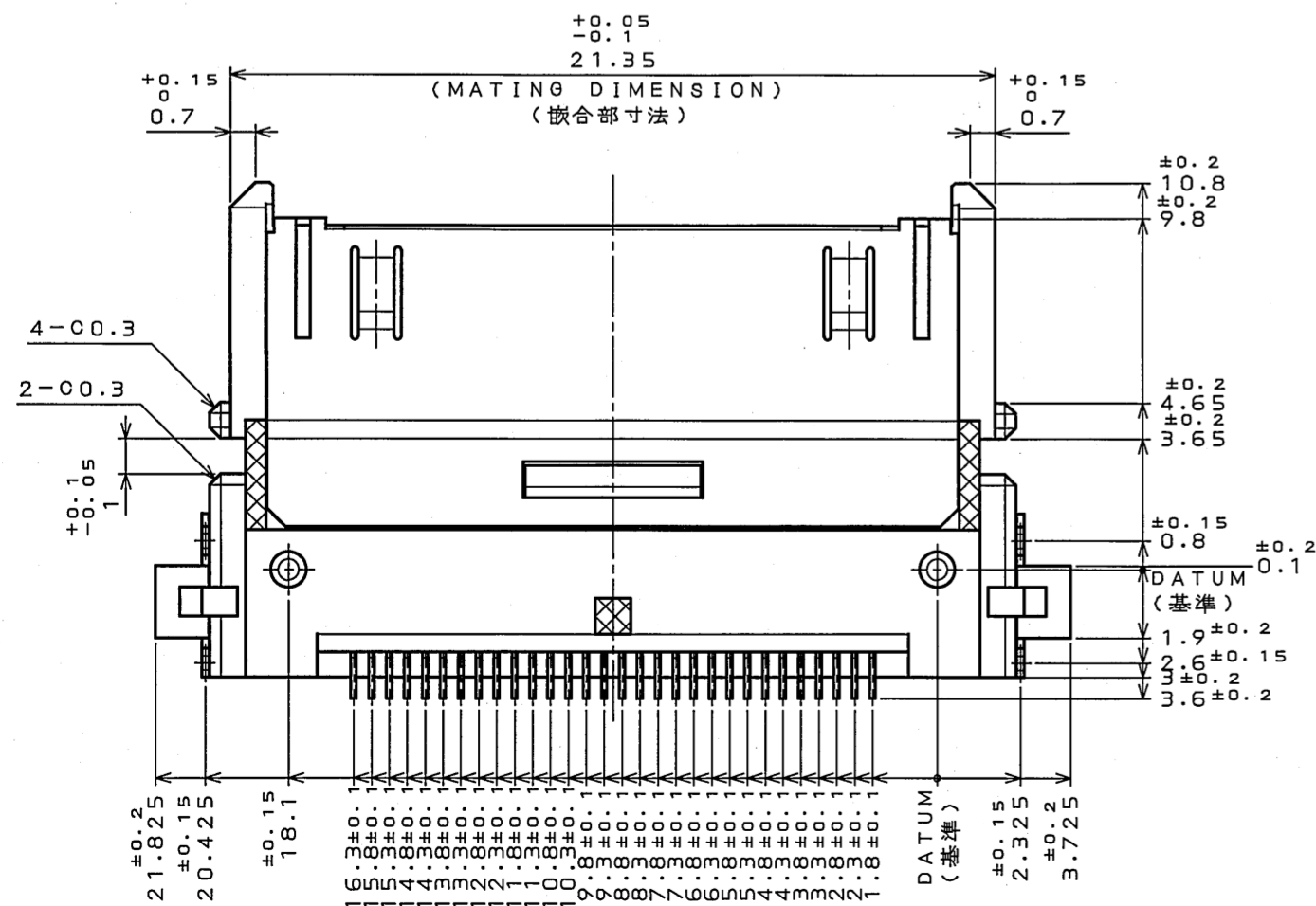
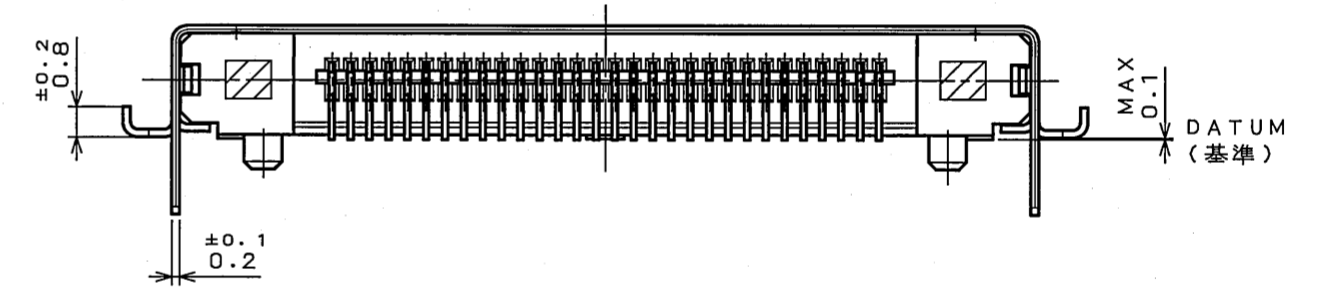
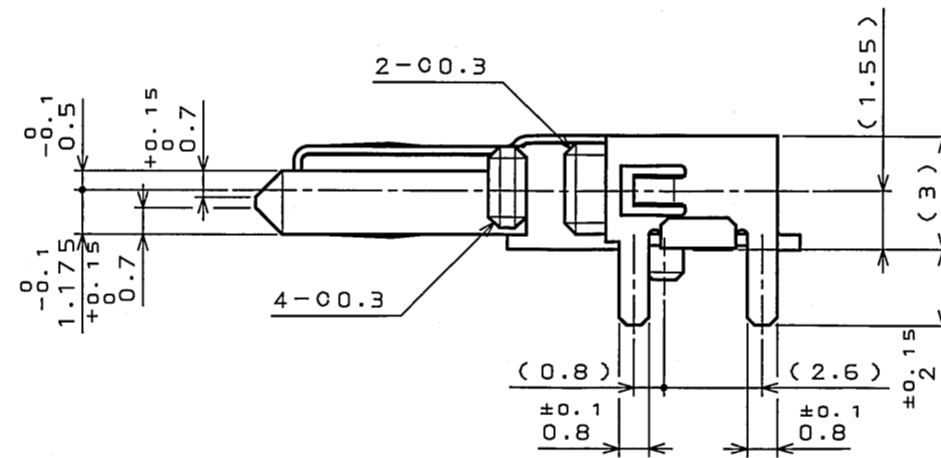
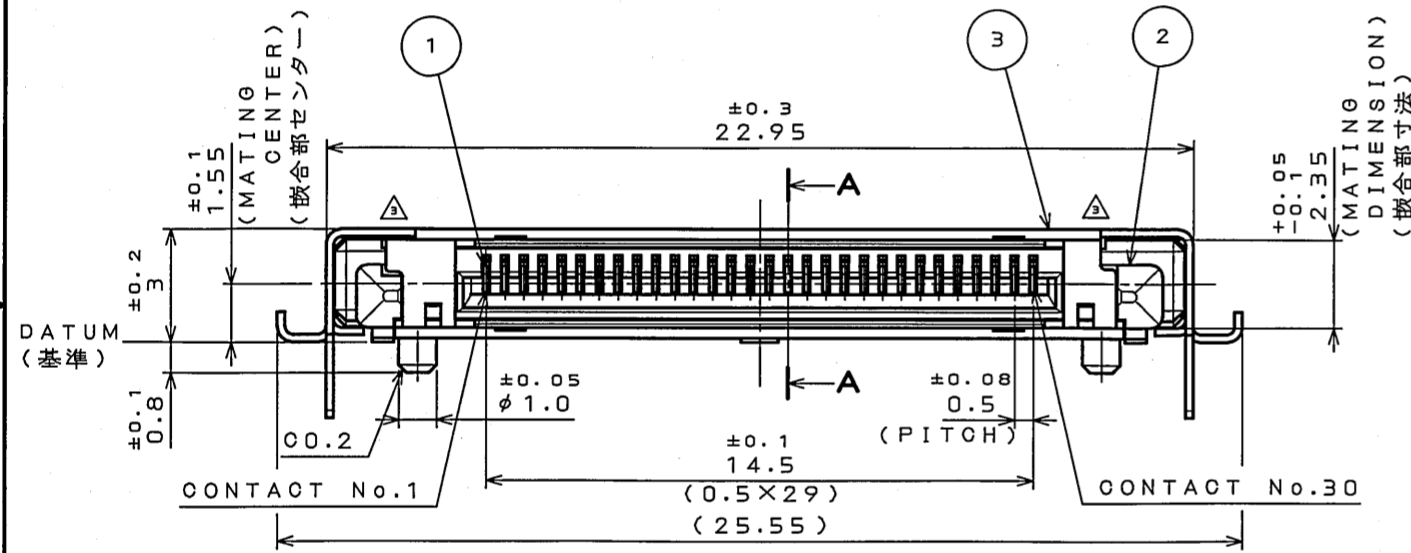
版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	1.Jul.2004	055417	ADDED NOTE4		Y.KUROKI		H.AMEMIYA
3	15.Mar.2005	056934	SHAPE CHANGE		Y.KUROKI		G. Hago



MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図 (参考)



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)



- NOTE1 ⊕ AND ⊖ DENOTE ARE DIRECTION OF SMT TOLERANCE. TERMINAL DIMENSION IS 0, AND DEVIATION (DIMENSION BETWEEN MINUS VALUE & PLUS VALUE) SHALL BE 0.1 MAX.
- LAND MARK BOTH SIDES OF P.C.B. HOLE IS THROUGH HOLE PLATED.
 - PLEASE NO PATTERNING IN SLANT AREA.
 - △ 4. USE JIG OR DISPOSABLE BACKUP BOARD FOR DATUM PLANE (3 AREA) RETENTION.

- 注1. SMT公差部のプラス、マイナスの方向を示す。端子寸法は "0" であり、公差内におけるバラつき (1コネクタ内のMAX値とMIN値の差) は0.1以下とする。
- ランドは基板の両側に設けること。また、スルーホール穴はスルーホールメッキであること。
 - 図に示す範囲をパターン禁止領域とする。
 - 図に示す範囲は倒れ防止の捨て基板とする。図示の位置にVカットを入れ、リフロー後に折り取ること。

3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING THROUGH HOLE AREA; TIN PLATING	
2	INSULATOR	1	9T NYLON	(BLACK)	UL94V-0
1	CONTACT	30	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL SMT AREA: GOLD FLASH OVER NICKEL	GOLD: 0.1μm MIN GOLD FLASH: 0.03~0.1μm
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	JACS-3285	第1版 (ORIGINAL DATE)	4.Mar.2004	版 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	Y.KUROKI	DD1B030HA1	
. ±	° ±	査閲 APPD.			
.X ±	°X ±	承認 APPD.	H.AMEMIYA		
.XX ±					
.XXX ±					
		質量 (MASS)			